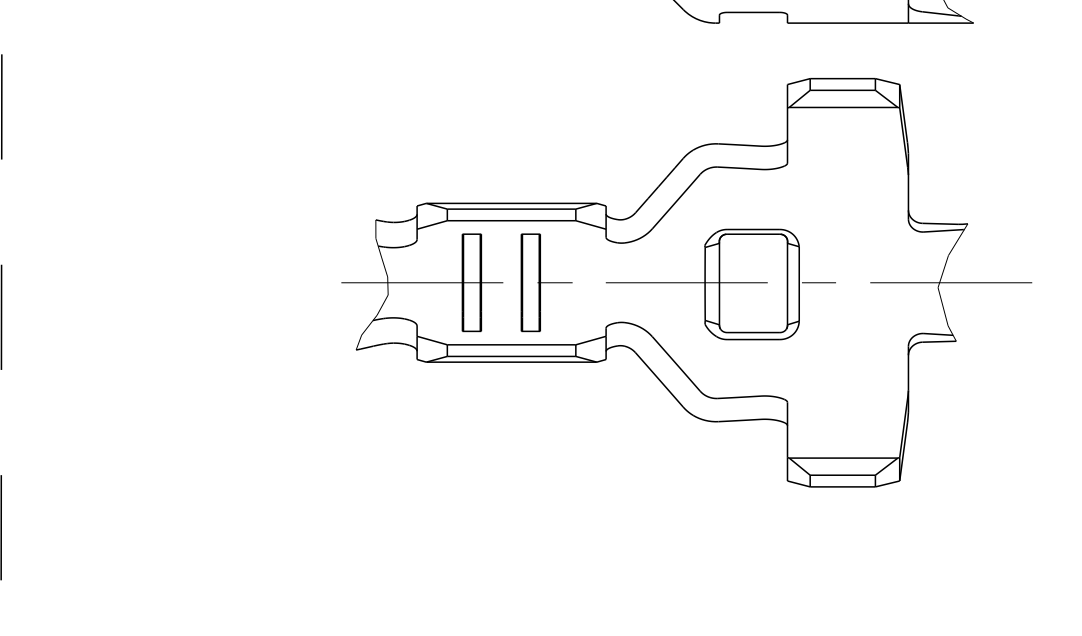
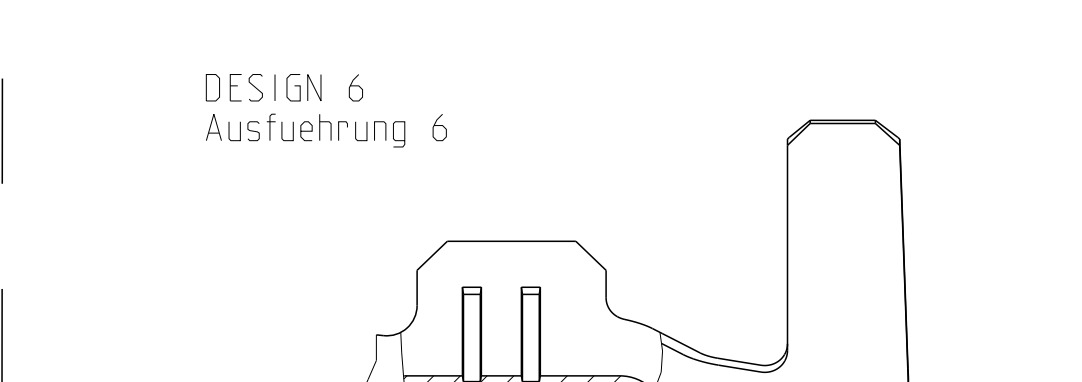
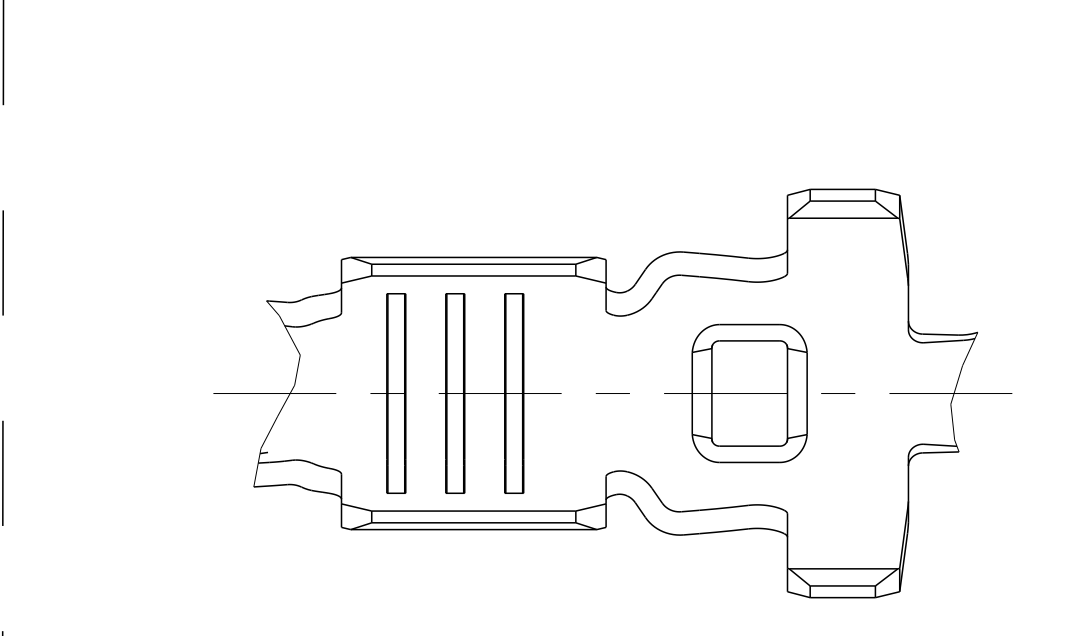
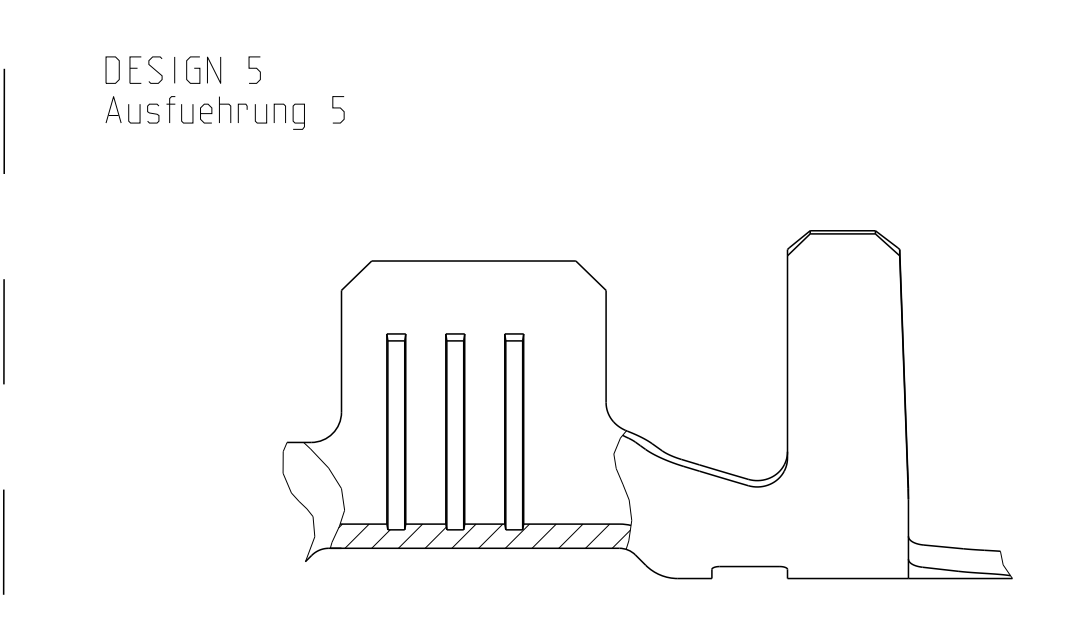
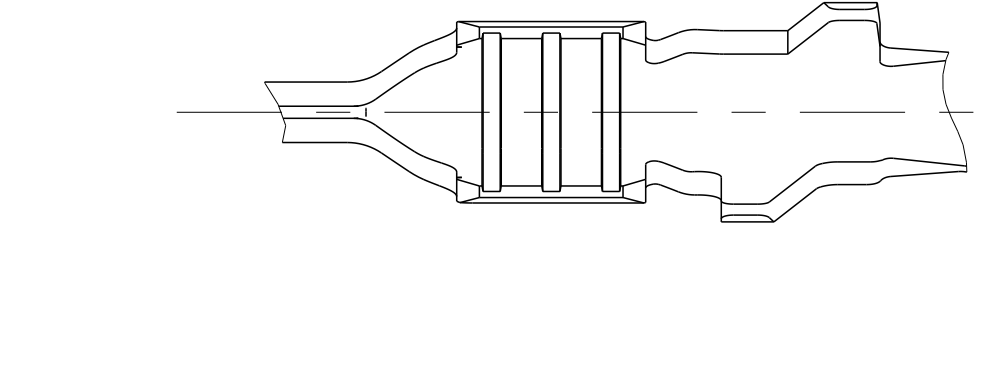
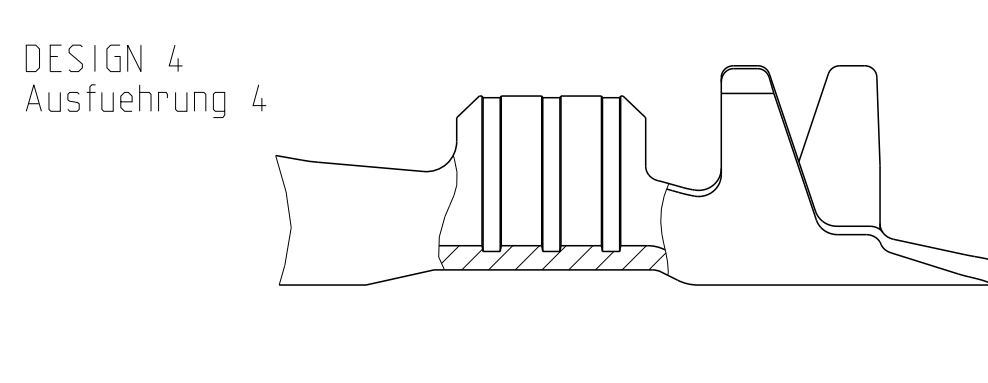
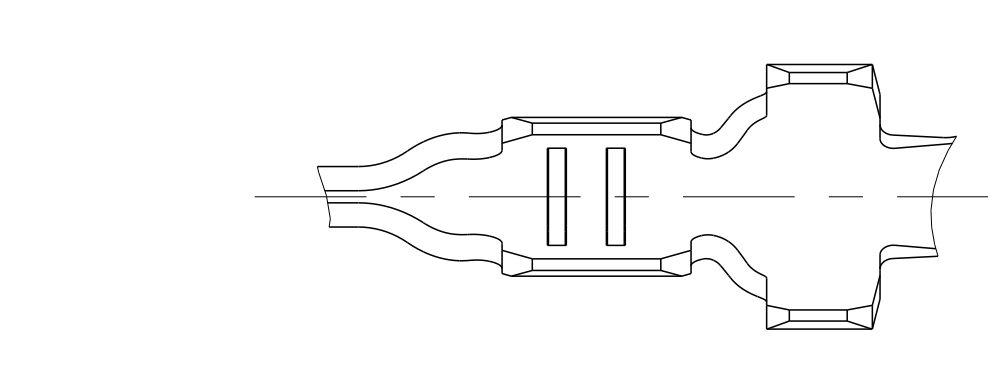
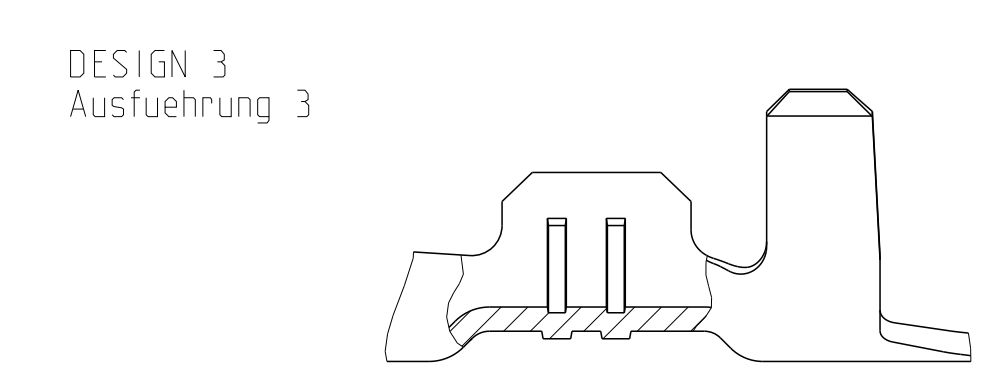
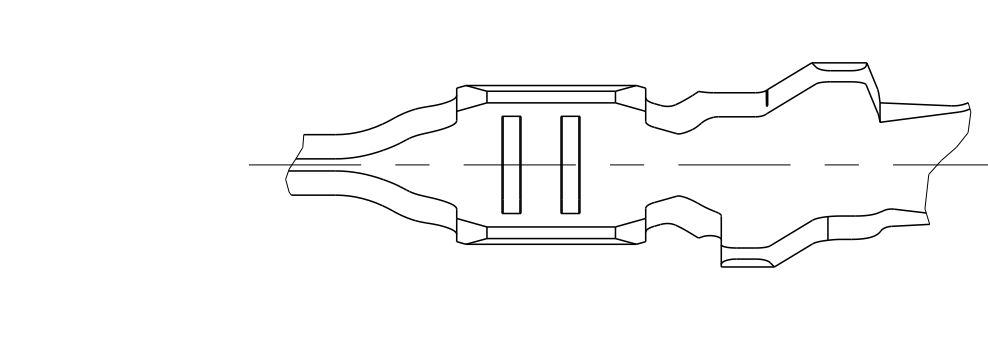
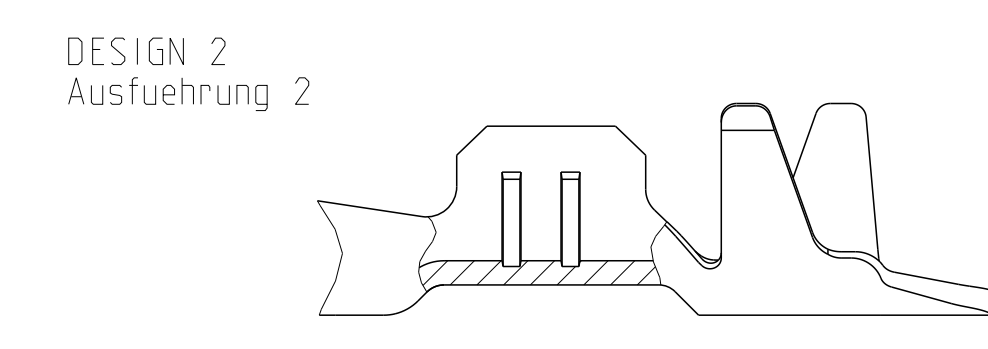
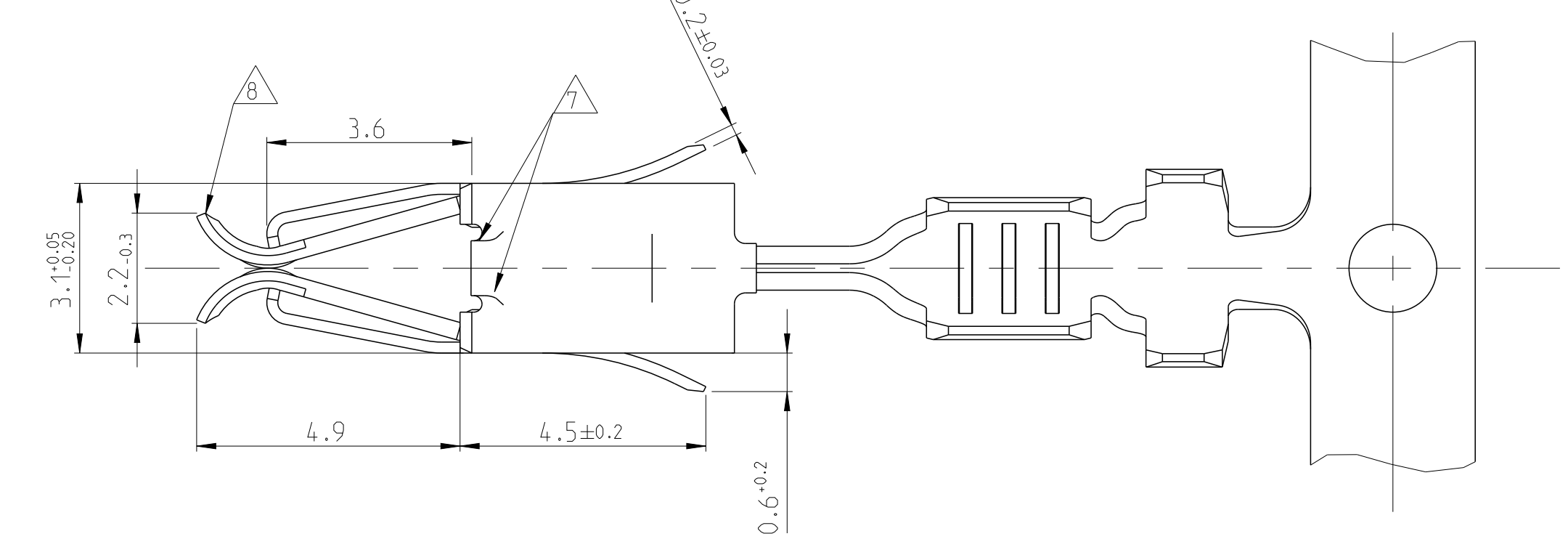
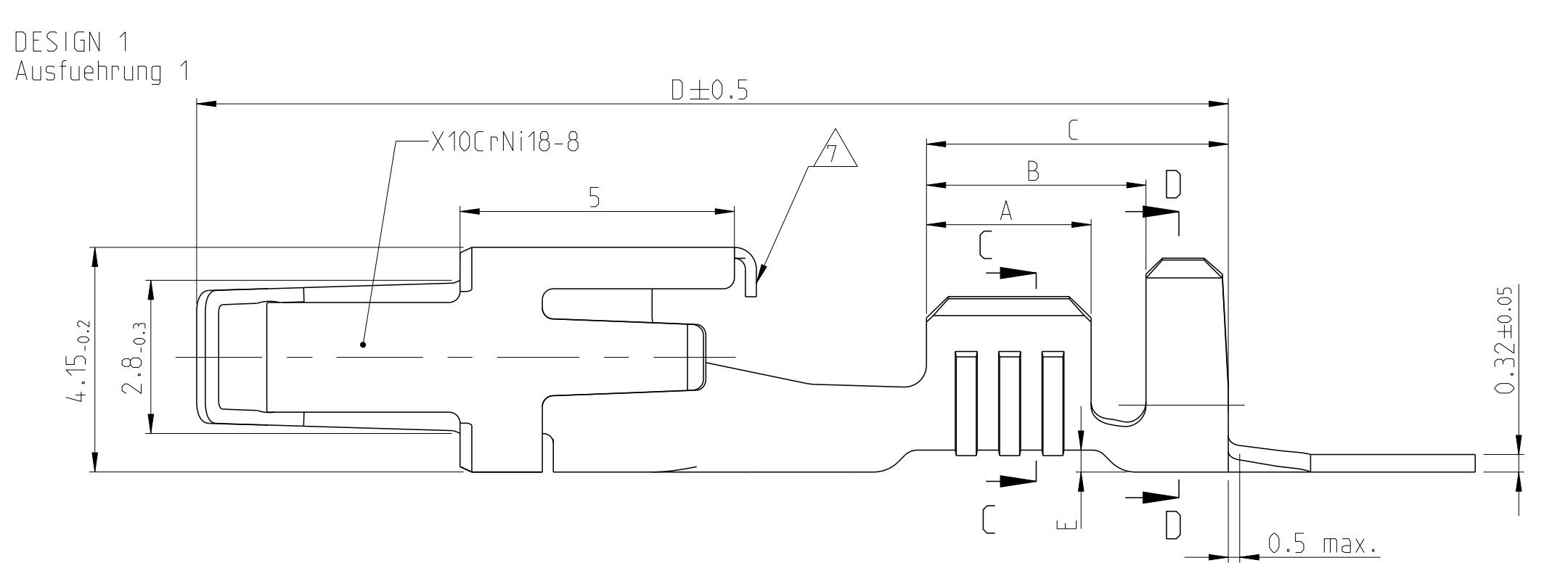
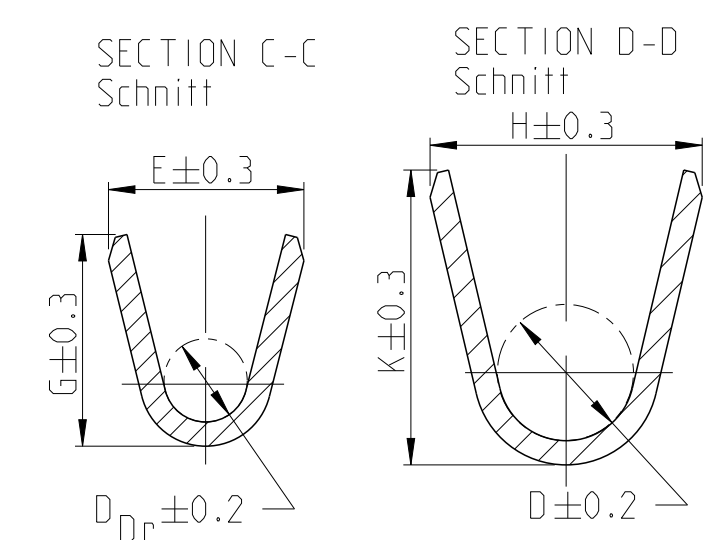
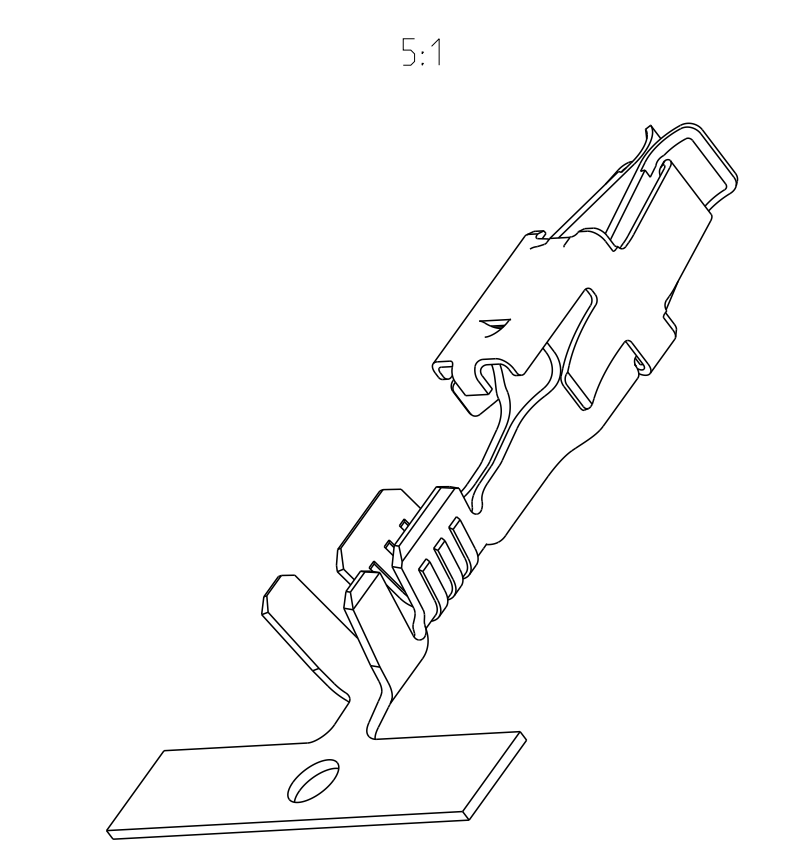
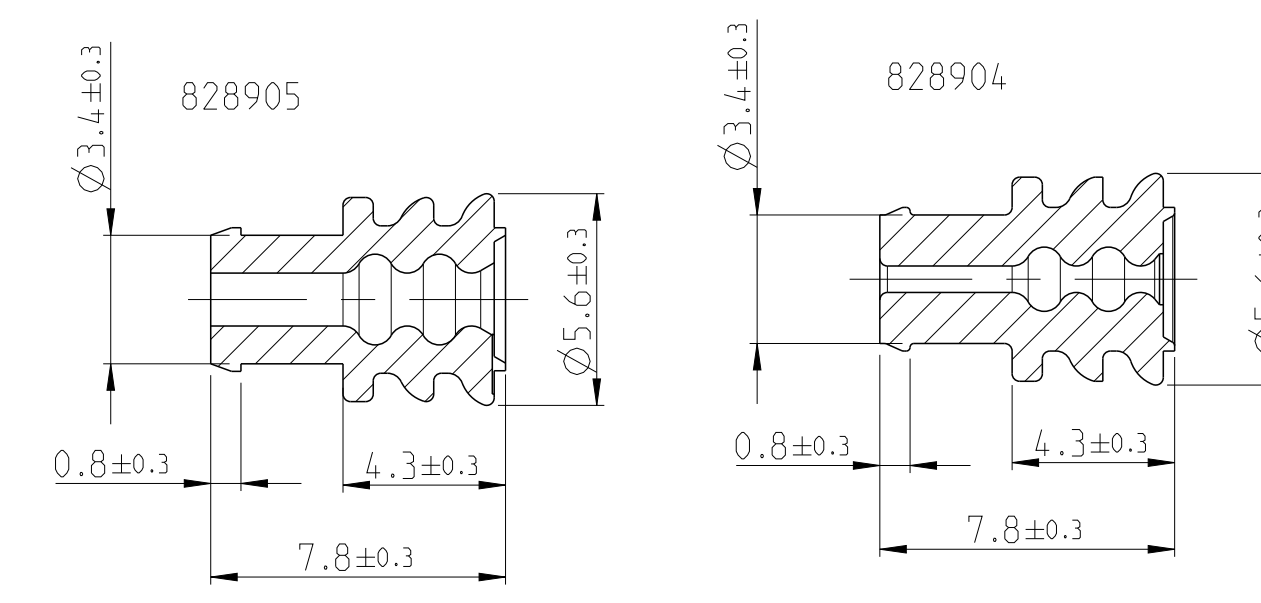


REV.	DESIGN	MATERIAL	SURFACE	WIRE RANGE	INSULATION	STRIP FORM	A	B	C	D	E	
1	A	CuSn4	PRET INNED vorverzinkt min. 0.8 µm	0.5-1.0 FLR	1.4-2.3	E = 2.6 G = 2.8 D _{Dr} = 1.1	H = 3.6 K = 3.9 D = 1.8	3	4	5.5	18.8	0.4
1	A	CuSn4	PRET INNED vorverzinkt min. 0.8 µm	>1.0-2.5 FLR	2.1-3.1	E = 3.6 G = 3.8 D _{Dr} = 1.8	H = 4.7 K = 4.9 D = 2.6	3.3	4.3	5.8	18.8	0.4
1	A	CuSn4	PLAIN BLANK	0.5-1.0 FLK	2.0-2.7	E = 2.6 G = 2.8 D _{Dr} = 1.1	H = 3.9 K = 4.1 D = 2.4	3	4	5.5	18.8	0.4
1	M	CuNi12ZN24	PRET INNED vorverzinkt min. 0.8 µm									
1	M	CuSn4	PRET INNED vorverzinkt min. 0.8 µm	0.5-1.0 FLK	2.0-2.7	E = 2.6 G = 2.8 D _{Dr} = 1.1	H = 3.9 K = 4.1 D = 2.4	3	4	5.5	18.8	0.4
1	M	CuFe2	PRET INNED vorverzinkt min. 0.8 µm									
1	A	CuFe2	PRET INNED vorverzinkt min. 1 µm	0.5-1.0 FLR	1.4-2.3	E = 2.6 G = 2.8 D _{Dr} = 1.1	H = 3.6 K = 3.9 D = 1.8	3.0	4.0	5.5	18.8	0.4
1	A	CuSn4	PRET INNED vorverzinkt min. 1 µm	>1.0-2.5 FLR	2.1-3.1	E = 3.6 G = 3.8 D _{Dr} = 1.8	H = 4.7 K = 4.9 D = 2.6	3.3	4.3	5.8	18.8	0.4
1	N	CuSn4	PRET INNED vorverzinkt min. 1 µm	>1.0-2.5 FLK	2.7-4.1	E = 3.6 G = 3.8 D _{Dr} = 1.8	H = 5.5 K = 5.8 D = 3.6	3.3	4.3	5.8	18.8	0.4
1	R	CuSn4										
1	R	CuFe2										
1	P	CuSn4		>1.0-2.5 FLR	2.1-3.1	E = 3.6 G = 3.8 D _{Dr} = 1.8	H = 4.7 K = 4.9 D = 2.6	3.3	4.3	5.8	18.8	0.4
1	P	CuSn4										
1	P	CuFe2										
1	A	CuSn4										
1	N	CuSn4										
1	N	CuFe2										
1	M	CuSn4		0.5-1.0 FLR	1.4-2.3	E = 2.6 G = 2.8 D _{Dr} = 1.1	H = 3.6 K = 3.9 D = 1.8	3	4	5.5	18.8	0.4
1	M	CuSn4										
1	M	CuSn4										
1	M	CuFe2										
1	C	CuSn4										
1	C	CuFe2										
1	B	CuSn4		0.2-0.5 FLR	1.0-1.6	E = 2.1 G = 2.1 D _{Dr} = 0.8	H = 2.7 K = 2.8 D = 1.4	2.5	3.5	5.6	18.8	0.4
1	B	CuSn4										
1	B	CuFe2										
2	B	CuFe2		0.08-0.2 Sonderleitung	1.5-1.8	E = 1.7 G = 1.7 D _{Dr} = 0.6	H = 3.1 K = 3.2 D = 1.6	2.5	3.7	5.9	18.8	0.4
3	A	CuSn4		0.2-0.5 FLR	1.2-2.3	E = 2.1 G = 2.1 D _{Dr} = 0.8	H = 3.5 K = 3.6 D = 2.0	2.5	3.5	5	18.8	0.4
3	C	CuSn4										
3	C	CuFe2										
4	A	CuSn4	PLAIN BLANK	0.2-0.5 FLR	1.15-1.6	E = 2.4 G = 2.3 D _{Dr} = 1	H = 2.9 K = 2.9 D = 1.4	2.5	3.5	5.6	18.8	0.2
5	E	CuSn4										
5	E	CuFe2		>1.0-2.5 FLK	2.7-3.0	E = 3.6 G = 3.8 D _{Dr} = 1.8	H = 5.4 K = 4.6 D = 3.2	3.5	5.9	7.5	18.8	0.4
5	D	CuSn4										
5	D	CuFe2										
5	E	CuSn4										
5	E	CuFe2										
5	E	CuSn4		>1.0-2.5 FLR	2.7-3.0	E = 3.6 G = 3.8 D _{Dr} = 1.8	H = 5.4 K = 4.6 D = 3.2	3.5	5.9	7.5	21	0.4
5	E	CuSn4										
5	E	CuFe2										
5	E	CuSn4		0.5-1.0 FLR	1.4-2.1	E = 2.6 G = 2.8 D _{Dr} = 1.1	H = 5.4 K = 4.6 D = 3.2	3	5.4	7	21	0.6
5	E	CuFe2										
5	E	CuSn4										
5	E	CuFe2										
5	E	CuSn4		0.5-1.0 FLR	1.4-2.1	E = 2.6 G = 2.8 D _{Dr} = 1.1	H = 5.4 K = 4.6 D = 3.2	3	5.4	7	18.8	0.6
5	E	CuFe2										
5	E	CuSn4										
5	E	CuFe2										
6	D	CuSn4		0.2-0.5 FLR	1.15-1.6	E = 2.1 G = 2.1 D _{Dr} = 0.8	H = 5.4 K = 4.6 D = 3.2	2.5	4.9	6.5	21	0.9
6	D	CuFe2										
6	D	CuSn4										
6	D	CuFe2										
6	D	CuSn4		0.2-0.5 FLR	1.15-1.6	E = 2.1 G = 2.1 D _{Dr} = 0.8	H = 5.4 K = 4.6 D = 3.2	2.5	4.9	6.5	18.8	0.9
6	D	CuFe2										
6	C	CuSn4										
6	C	CuFe2										



SEE APPLICATION - SPECIFICATION
siehe Verarbeitungspezifikation
114-18050

ORDER No. Bestell-Nr.	INSULATION Isolations Ø	COLOUR Farbe
828904-1	1.2-2.1	blue blau
828905-1	2.2-3.0	white weiss



NOTES
Bemerkungen

- CONTACT BODY PRE-SILVER PLATED MIN. 0.8 µm
Kontaktkoerper vorversilbert min. 0.8 µm
- CONTACT ZONE SELECTIVE PRE-SILVER PLATED MIN. 3 µm
Kontaktzone selektiv vorversilbert min. 3 µm
- CONTACT ZONE GOLD PLATED MIN. 0.8 µm OVER MIN. 1.3 µm NICKEL-LAYER
Kontaktzone vergoldet min. 0.8 µm ueber min. 1.3 µm Nickel-Zwischenschicht
- CANTILEVER SPRING INSIDE AND OUTSIDE 0.4-1.2 µm GOLD PLATED
Ueberfeder innen und aussen 0.4-1.2 µm vergoldet
- CONTACT BODY, CONTACT SPRING INSIDE AND CRIMP AREA MIN. 1 µm TIN PLATED OVER NICKEL-LAYER.
TOUCHING AREA TO CANTILEVER SPRING AND CONTACT SPRING OUTSIDE
SELECTIVE 0.8 µm GOLD OVER MIN. 1.3 µm NICKEL-LAYER
Kontaktkoerper, Kontaktfeder innen und Crimbereich min. 1.3 µm verzinkt ueber Nickel-Zwischenschicht, Anlageflaeche zur Ueberfeder und Kontaktfeder aussen selektiv 0.8 µm vergoldet ueber min. 1 µm Nickel-Zwischenschicht
- CONTACT ZONE AND TOUCHING AREA TO CANTILEVER SPRING MIN. 0.8 µm SELECTIVE GOLD PLATED OVER 1.3 µm NICKEL PLATED. CRIMP AREA MIN. 1 µm TIN PLATED OVER NICKEL-LAYER
Kontaktzone und Anlageflaeche zur Ueberfeder min. 0.8 µm vergoldet ueber min. 1.3 µm Nickel-Zwischenschicht Crimbereich min. 1 µm verzinkt ueber Nickel-Zwischenschicht
- CONTACT BODY AND CRIMP AREA MIN. 1 µm TIN PLATED OVER NICKEL-LAYER.
TOUCHING AREA TO CANTILEVER SPRING SELECTIVE 0.8 µm GOLD OVER MIN. 1.3 µm NICKEL-LAYER
Kontaktkoerper und Crimbereich min. 1 µm verzinkt ueber Nickel-Zwischenschicht, Anlageflaeche zur Ueberfeder selektiv 0.8 µm vergoldet ueber min. 1.3 µm Nickel-Zwischenschicht
- CONTACT OFF OPTIONAL
Abschnitt/Freisschnitt optional
- SAWAG ONLY FOR PN 929937, 929939, 929941
Swage nur fuer PN 929937, 929939, 929941
- VARIANTS WITH GAP-SIZE 0.3mm (±0.1)
Varianten mit Gap-Size 0.3mm (±0.1)
- CONTACTS DIPPED IN OR SPRAYED WITH LUBRICANT BARRIERTA
Kontakte getaucht oder besprueht mit Lubricant Barrierta
- ACCORDING INSULATION DIA IS TO CHOOSE THE SINGLE WIRE SEAL
Entsprechend dem Isolationsdurchmesser ist die Einzel-Dichtung auszuwaehlen
- VARIANTS WITH GAP-SIZE 0.65mm (±0.1)
Varianten mit Gap-Size 0.65mm (±0.1)
- VARIANTS WITH GAP-SIZE 0.15mm (±0.05)
Varianten mit Gap-Size 0.15mm (±0.05)

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT. DIMENSIONS: mm	DATE: 09JUN99 CHK: Hgs	DATE: 09JUN99 APP: Hgs	PRODUCT SPEC: 108-18013 APPLICATION SPEC: 114-18050	PRODUCT GROUP DRAWING FOR JUNIOR POWER TIMER CONTACT Produkt-Gruppen-Zeichnung fuer JPT	RESTRICTION TO: -
MATERIAL: SEE TABLE	SCALE: Customer Drawing	SHEET: 5.1	OF: 1	REV: A.16	

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru